



410082

湖南省长沙市岳麓区湖南大学半导体学院（集成电路学院）

刘杰(13787181681)

发文日：

2026年06月18日



申请号：202610888384.8

发文序号：2026061801310240

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2026108883848

申请日：2026 年 06 月 18 日

申请人：湖南大学,岳麓山工业创新中心

发明人：刘杰,韦宇鹏,曾弘逸,刘鸿涛

发明创造名称：一种面向掩膜数据准备的版图裂解方法

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 2 页,权利要求项数：9 项

说明书 1 份 5 页

说明书附图 1 份 5 页

说明书摘要 1 份 1 页

发明专利请求书 1 份 5 页

实质审查请求书 文件份数：1 份

提示：

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。

2. 申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员：自动受理

联系电话：010-62356655

审查部门：初审及流程管理部

